,	池州华宇电子科技股份有限公司						客户代码 008 线B Customer No. Drawi			♥ HY-PX-008-794 A				
-	Hisemi chi zhou hisemi electronics technology co.,Lt 焊线图纸 Bonding Diagram					产品名称 Product Type HS23P6315		封裝外型 PKG Type SOP16L						
焊丝 Wir	焊线种类 焊线直径(um) 焊线根数 焊线总长(um		焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型 Compound	号(绿色环保) Type (Green)	LF载体尺寸 LF Pad Size						
	金丝 Ag	2	0	16	30078	1979	1139	首选(Preferred): C 备选(Optional): E	EL-1702HF ME-G630AY	SOP16L-8R (134*9 (3400*2300um²)	1mil²)-E8			
Custo	客户图· omer draw													
	15 16	ing NO.		14		5 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		12		11		10 9	}	
	\ \cdot \c					to:			特殊说明 Special Instructions: DB注意: 芯片居中放置; WB注意: 数字为不打线pad点个数。					
说明 Instructions		胶类型 ky type	芯片 Die	· 名称 name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm²)	最小焊盘间距 Min BPP(µm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Water Size	是否是 Line-K If low-k?	滅游厚度 (jum) Wafer Theckness	
A芯: DIE A	(condu	电胶 uctivity) 210	HS	5131	1155.2*866.4(um²) 45.48*34.11(mil²)	57*61.75	94	1	是/Yes	60	8	否/N0	300	
B芯:	52	210												
DIE B														
C芯: DIE C			7/											
拟 Prepar	拟制 Prepared by		the rory 9.9		制图日期 Create Date	2024/	9/9	生效日期 Effective Date			客户确认 Customer		作:	
研发	研发审核 R&D Check		130		产品工程审核			批准 Approved by			1			
		D产品下线生	产的唯一依	4. 3. / 据,请想认真领	PE Check 门认,我司依据您回	签后的图纸生产,	如图纸错误会产生	Approved by 不可估量损失,谢	射! ding to the drawings			页码	Page	
*warm tips drawing mi	: the draw istakes, wh	ing is the onl nich will prod	ly basis for the luce inestimab	production of the le loss. Thank you	e product. Please con	firm it carefully. Our	company will produc	e the drawings accor	rding to the drawings	you have signed back	k, such as		/ 1	